

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**SOLOMON
SYSTECH**

SOLOMON SYSTECH (INTERNATIONAL) LIMITED

晶門半導體有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：2878)

**授出購股權
補充公告**

茲提述晶門半導體有限公司（「本公司」）於2023年3月24日刊發有關授出購股權的公告（「該公告」）。除文義另有指明者外，本公告所用詞彙與該公告所用者具有相同涵義。

本公司謹就該公告的內容作出以下澄清及補充：

購股權行使價

所授出的500,000份購股權的行使價應為每股本公司股份（「股份」）0.546港元，而非每股股份0.534港元。

行使價為以下價格的最高者：(i)股份於授出日期按聯交所每日報價表所載的收市價每股0.50港元；與(ii)股份於緊接授出日期前五個營業日（定義見上市規則）按聯交所每日報價表所載的平均收市價每股0.546港元。

承授人的資料

該500,000份購股權是向本集團一名負責本集團財務報告及財務管理事宜的僱員(「承授人」)作出，以回報彼為本集團作出的貢獻。此次授出購股權毋須經本公司股東於股東大會上批准。

據董事所深知，截至本公告日期，承授人並非(i)本公司董事、行政總裁或主要股東、或彼等任何一名的聯繫人(定義見上市規則)；(ii)已獲授予及將獲授予超逾上市規則項下所述1%個人限額的購股權及獎勵的參與人；或(iii)本公司的關連實體參與者或服務提供者(定義見上市規則)。此次授出購股權不會導致就於直至此次授出之日(包括該日)止12個月期間內授予該承授人的所有購股權及獎勵而發行及將予發行的股份合共超過已發行股份的1%。

表現目標及退扣機制

購股權並無附設表現目標或退扣機制。

財務資助

本集團並無向承授人提供任何財務資助以協助其購買2013購股權計劃項下的股份。

未來可授出的股份數目

於本公告日期，未來根據2013購股權計劃可授出的購股權數目為92,330,235份。

上述資料不影響該公告載列的其他資料。除上文所披露外，該公告所有其他資料維持不變。

承董事會命
晶門半導體有限公司
公司秘書
余俊敏

香港，2023年3月28日

於本公告刊發日期，董事會由(a)執行董事－王華志先生(行政總裁)；(b)非執行董事－馬玉川先生(主席)、王輝先生及康劍博士；及(c)獨立非執行董事－梁享英先生、許維夫先生及陳正豪博士組成。